

2008年3月期 決算説明会

株式会社ディスコ

2008年5月13日
大和コンファレンスホールA2B

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動等があります。

1. 2008年3月期決算概要

常務取締役 I R 担当

関家圭三

2. 今期の事業環境と経営方針

代表取締役社長

溝呂木 斉

3. 質疑応答

1. 2008年3月期決算概要

常務取締役 I R担当

関家圭三

2. 今期の事業環境と経営方針

代表取締役社長

溝呂木 斉

3. 質疑応答

プレゼンテーション

常務取締役 関家 圭三

2008年3月期決算概要

(単位: 億円 四捨五入)	2005年度	2006年度	2007年度	対前年比 (%)	備考
売上高	688	861	916	6.3%	過去最高の売上高を更新
売上総利益	361	440	468	-	
GP率	52.5%	51.1%	51.1%	0pt	前年と同水準を維持
営業利益	139	195	193	-1.0%	販売管理費増により若干減益
経常利益	144	196	185	-5.6%	営業外費用: 為替差損12億円
経常利益率	20.9%	22.8%	20.3%	-2.5pt	
税引き前利益	133	177	184	-	
当期純利益	82	109	111	1.6%	外国税額控除分8億円等
一株あたり利益(円)	251.85	321.22	326.27	-	
受注高	708	868	923		
受注残	79	86	92		

●本年4月に速報開示で発表した通り、売上高は予想数値945億円に比較して29億円減の916億円となりました。

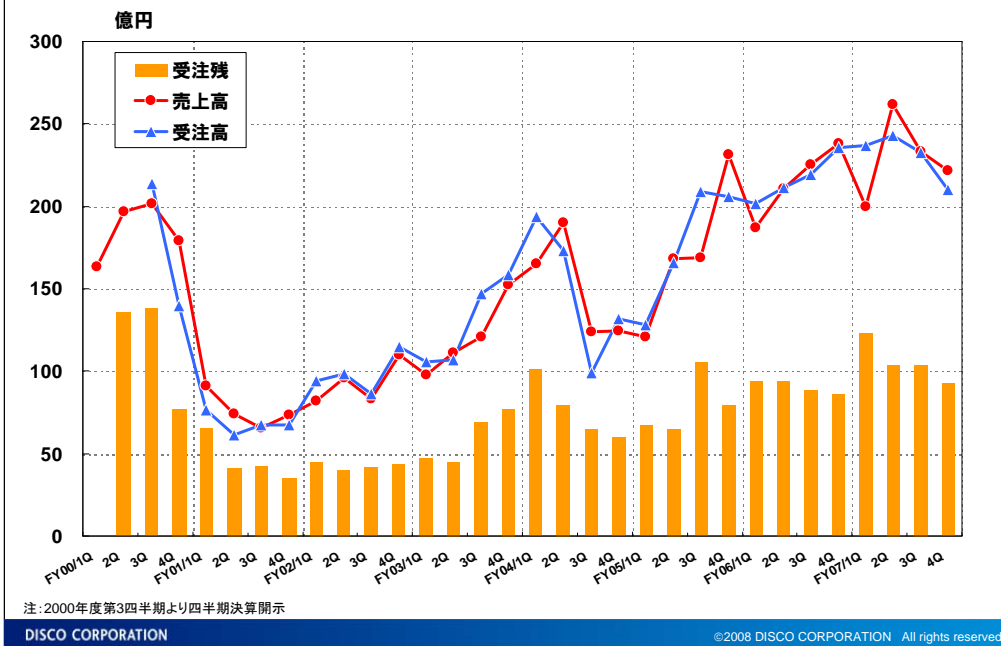
●予想数値との乖離の理由としては、第4四半期に入ってアジア地域が減速したことと、2月から3月の急激なドル安の進行により、海外向けのドル建てでの販売において売上債権の目減りがあったことが挙げられます。

●一方素材ウェーハ向け研削装置、パッケージ向け切断装置においては戦略的な投資が行われた結果堅調に推移し、通期全体の売上高では対前年比で6.3%増となりました。

●営業利益は193億円、経常利益は185億円。当期利益は111億円で、対前年比1.6%増となりました。

●受注高は売上高を若干上回って923億円、受注残は92億円となりました。

連結売上高・受注高推移

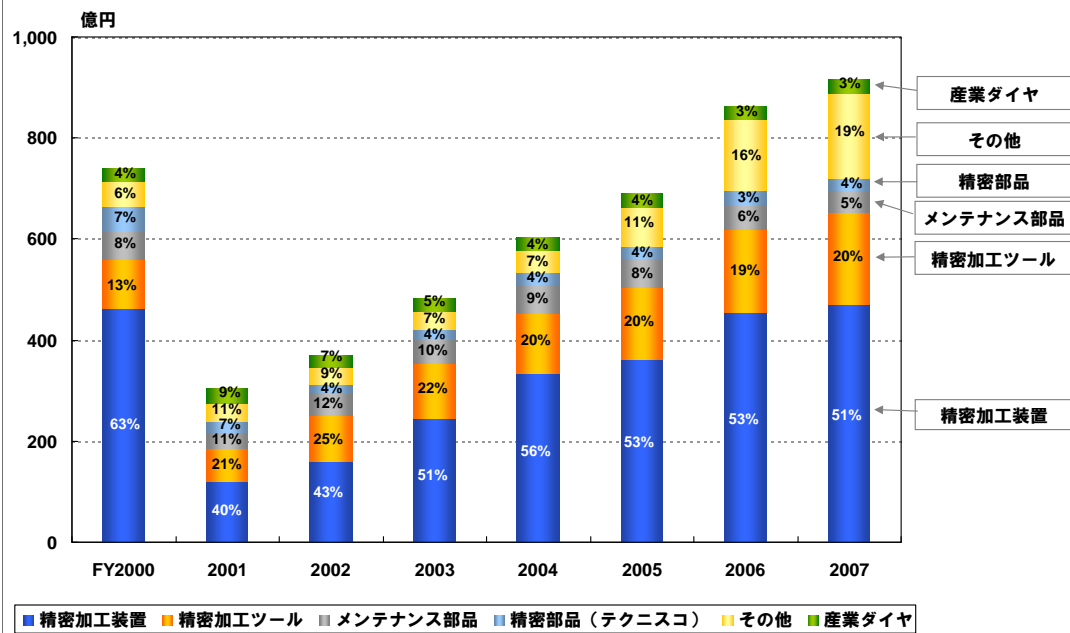


●2007年度の四半期別の推移では、第1四半期では売上が受注より落ち込みましたが、その要因は受注が6月以降急激に伸びたためです。

●その結果、第2四半期の売上が受注を上回りました。

●第3四半期はほぼ通常通りの動き（売上と受注が同じような水準）でしたが、第4四半期に入って売上と受注がやや減速し、グラフのような推移となりました。

連結売上高 製品群別構成比

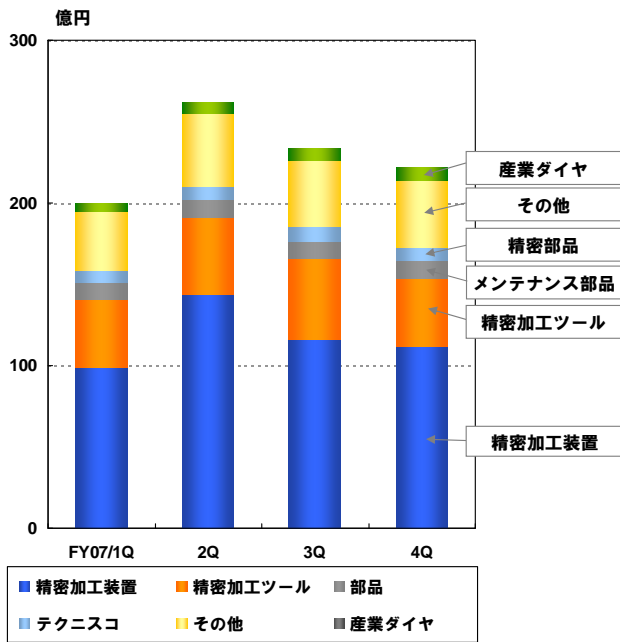


●製品群別の売上構成では、2007年度は2000年度と比較しても精密加工装置が過去最高の売上となりました。

●精密加工ツールは毎年売上高を更新し、2007年度も過去最高となりました。

- ・ 2007年度の第2四半期、第3四半期と続けて過去最高の売上高を更新しました。
- ・ 第4四半期に入ってから半導体生産数量の伸びが鈍化し、若干減速しました。

連結売上高 製品群別構成比 四半期推移

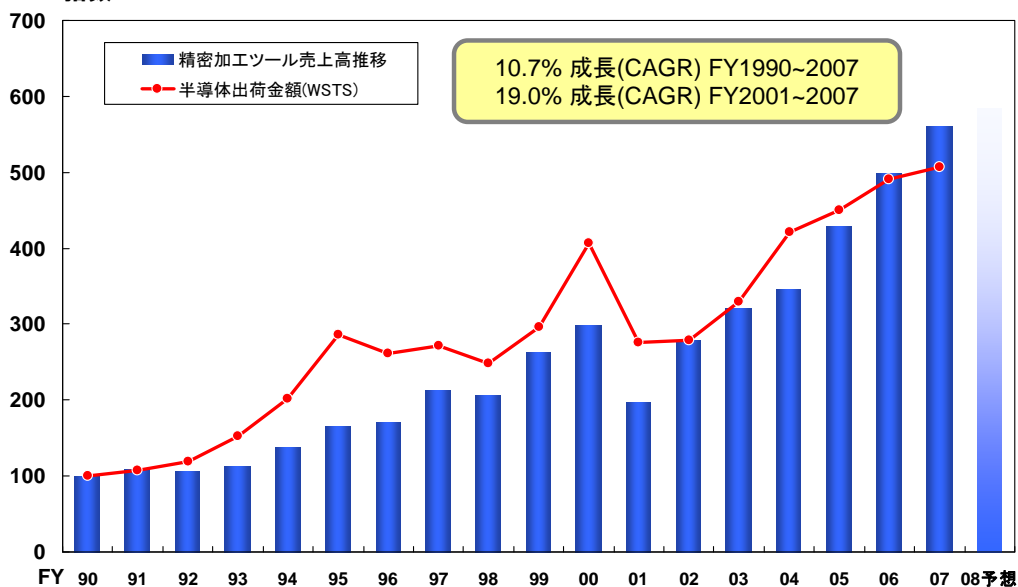


- 1Qにメモリ市況の悪化から低迷した台湾、韓国が2Qに入って復調
- 上期実績では過去最高の前下期とほぼ同水準の売上を達成
- 精密加工ツールは、生産数量の増加局面が続き2Q,3Qと過去最高を更新
- 3Q後半以降、サブコンを中心に投資抑制の動きがありやや減速
- しかし、精密加工装置、精密加工ツールともに通期では過去最高の売上を達成

- 2007年度の第2四半期は特に精密加工装置が大きく伸びました。
- 第4四半期に入って、精密加工ツールが若干減速しました。

精密加工ツール売上高推移 (単体)

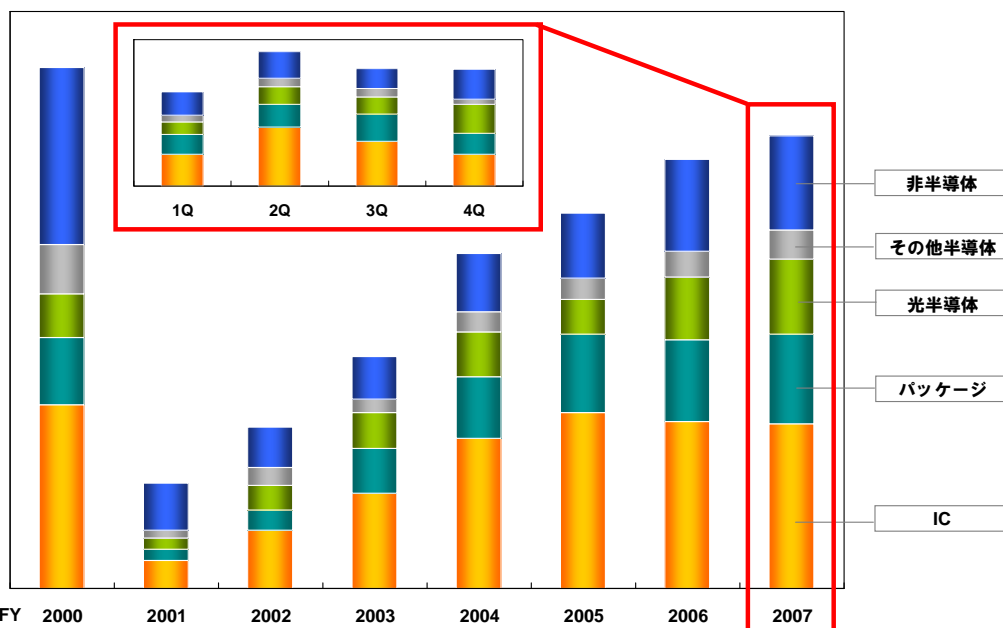
指数 FY1990=100



●2001年度から2007年度までの精密加工ツール売上高の平均成長率は19%となりました。

●2008年度も半導体・電子部品生産数量のプラス伸張を予想しており、過去最高であった2007年度の売上高をさらに更新することを見込んでいます。

ダイサ売上構成 (アプリケーション別・単体)



●ダイサのアプリケーション別構成では、ここ数年IC向けはほぼ横ばいとなっています。

●パッケージ向け、光半導体(LED向け)が売上を牽引しています。

●四半期別推移の特徴としては、2007年度第3四半期以降、サブコンを中心とした投資抑制の動きもありIC向けが徐々に減速しました。光半導体向けでカバーした形となっています。

グラインダ売上構成 (アプリケーション別・単体)

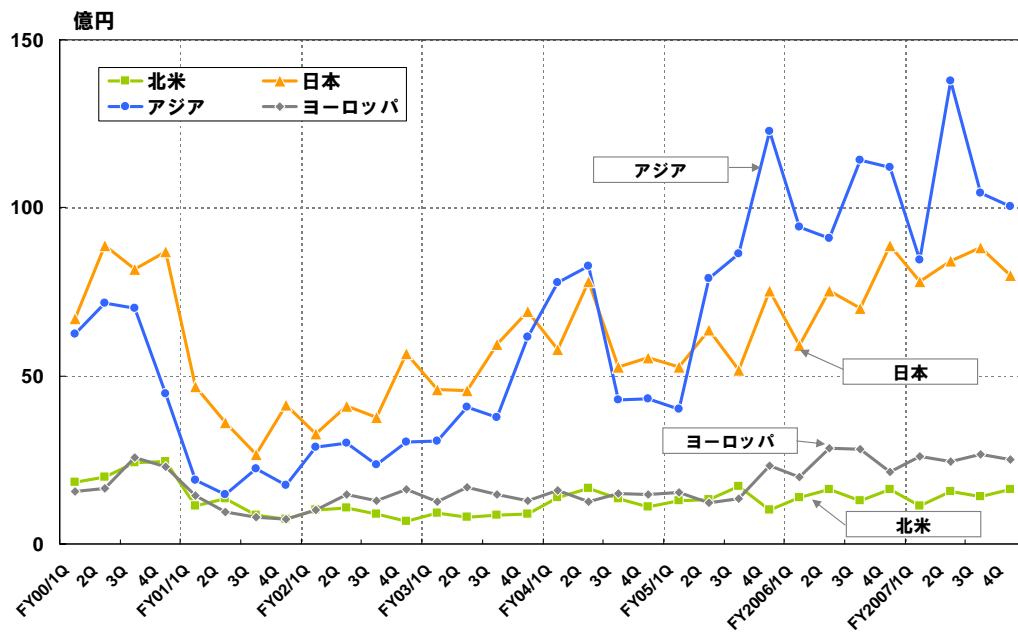


●グラインダのアプリケーション別構成では、素材ウェーハ向けが大きく伸びました。

●半導体向けの売上は2007年度第1四半期、第3四半期の落ち込みもあり、年度比較ではやや減少しました。

●素材ウェーハについては、年度末に入って若干減速。大きな投資が一巡しつつあることが要因と考えています。

地域別売上高推移



- 大きな波があるものの、アジアの伸びが顕著。売上構成比としては47%を占めています。
- 日本はアジア同様に堅調でした。
- ヨーロッパ、北米は横ばいとなっています。

バランスシート (抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)	2006年度	2007年度	増減
	通期末 (07年3月31日)	通期末 (08年3月31日)	対前年比
流動資産	758	699	-59
現預金	270	191	-79
受取手形・売掛金	278	271	-7
棚卸資産	173	199	26
その他	38	38	-
固定資産	380	487	107
有形・無形固定資産	345	421	76
投資その他の資産	35	66	31
資産合計	1,138	1,186	48
流動負債	288	263	-25
固定負債等	31	26	-5
株主資本等	819	897	48
自己資本比率 (%)	71.5%	75.0%	3.5pt
負債純資産合計	1,138	1,186	48

●現預金の減少79億円のうち、40億円は長期性預金への振り替えによるもの。残りの39億円は、工場等建設の支払いが主なものです。

●固定資産の増加107億円の主な内訳は、工場等建設にかかわるもので、建物27億円、建設仮勘定で29億円となっています。

●負債等について特記事項はありません。

●自己資本比率は75%に上昇しました。

キャッシュフロー(抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)

	2006年度 通期	2007年度 通期	2007年度中間期 (ご参考)
営業キャッシュフロー	132	93	33
税前純利益	177	185	110
減価償却費	30	37	15
売上債権・棚卸資産・仕入れ債務	-29	-35	-31
法人税等の支払額	-65	-89	-50
その他	19	-5	-12
投資キャッシュフロー	-90	-118	-61
有形固定資産の取得による支出	-49	-94	-31
定期性預金の預入による支出・収入他	-41	-24	-30
財務キャッシュフロー	-24	-32	-19
有利子負債の減少	-3	-2	-3
親会社による配当金の支払額	-22	-27	-15
その他	1	-3	-1
フリーキャッシュフロー	42	-25	-28
現金および現金同等物の増加額	20	-60	-46
現金および現金同等物の期末残高	241	181	195

●営業キャッシュフローで、棚卸資産が24億円増加しました。これは第4四半期の出荷見込み分が顧客の都合で一部延期となり、期末に残高として残ったものです。

●投資キャッシュフローのマイナスは、定期性預金への振り替えと有形固定資産の取得による支出が中心となっています。

●財務キャッシュフローについては、配当金の支払いが主なものです。

●結果、現預金等の期末残高は181億円となりました。

2009年3月期業績予想

(単位: 億円 四捨五入)	上期予想	下期予想	通期予想 (5月12日)	【ご参考】 2007年度 通期	対前年比
売上高	453	437	890	916	-2.9%
営業利益	83	80	163	193	-15.7%
営業利益率	18.3%	18.3%	18.3%	21.1%	-2.8pt
経常利益	84	86	170	186	-8.4%
経常利益率	18.5%	19.7%	19.1%	20.3%	-1.2pt
当期純利益	47	53	100	111	-10.0%
純利益率	10.4%	12.1%	11.2%	12.1%	-0.9pt

減価償却費、先行開発投資の継続によるR&D費用等の増加により合計20億円弱の利益減少要因

特別損失 低価法対処、建物の除却損等で7.8億円を見込む
為替前提 US\$:100円 EUR:150円 SGP\$:70円

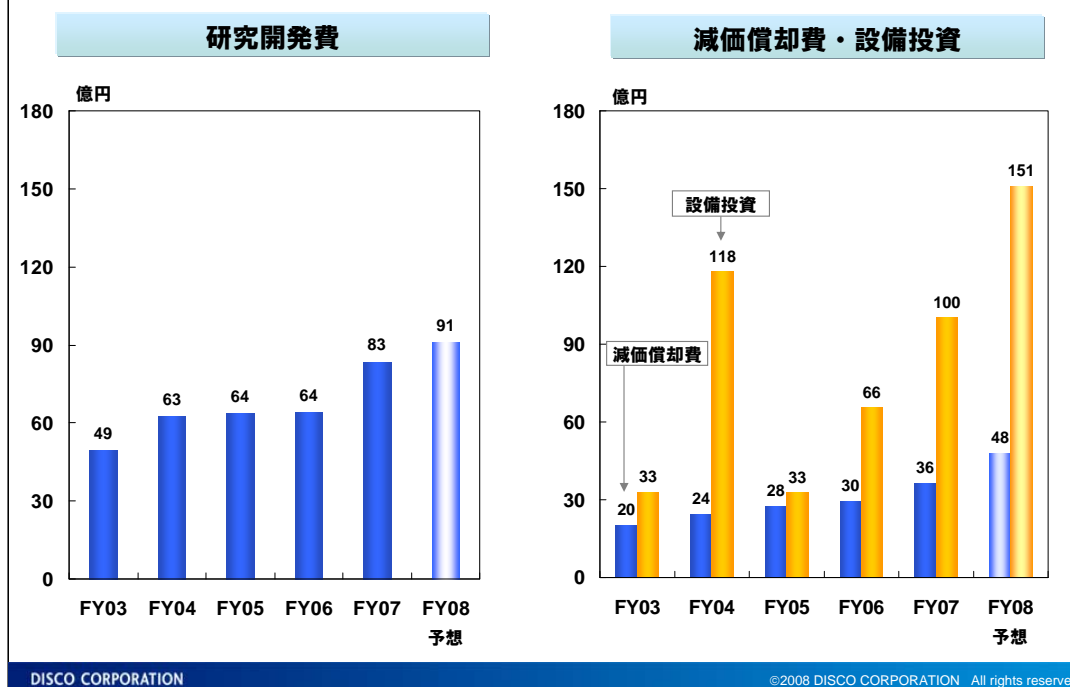
●2008年度の通期は890億円の売上高を予想。2007年度比2.9%減の見込みです。

●未だにメモリの生産能力過剰によるマイナス要因がある一方、戦略的投資の継続によるポジティブ要因が見込まれ、大きなマイナス幅（減収）にはならないと想定しています。

●営業利益は163億円、経常利益は170億円。当期利益は100億円で、10%の減益見込みです。

●為替前提は表の通り、1ドルを100円でみています。対ドルで5円ドル高になれば、売上高および営業利益で大体7億円から8億円増加すると見えています。

●その他特別損失では棚卸資産の低価法対処と建物の除却損等で7.8億円を見込んでいます。



●R&D費用は、2007年度83億円の着地実績、2008年度は、前年比8億円増加の91億円を計画しています。

●2008年度の減価償却費は、48億円を見込んでいます。

●2008年度の設備投資は本社・R&D新棟の完成、生産拠点・桑畑工場の新棟建設（免震構造）などで151億円を予定しています。

1. 2008年3月期決算概要

常務取締役 I R担当

関家圭三

2. 今期の事業環境と経営方針

代表取締役社長

溝呂木 斉

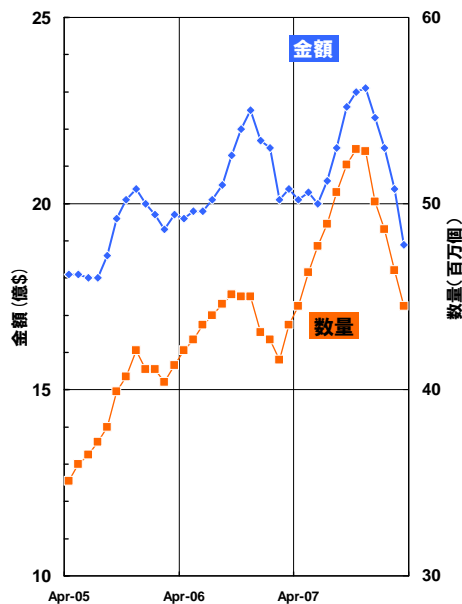
3. 質疑応答

事業環境

プレゼンテーション

代表取締役社長 溝呂木 斉

半導体出荷推移(WSTS)



市場環境

- 半導体業界全体は低調
 - 市場の動きを窺っている分野/メモリ
 - 積極的に投資する分野/LED
- 08年度半導体製造装置の投資動向
 - 調整期間は長期化しない
 - 組立装置の落ち込みは装置市場全体と比べると小さい
- 数量ベースでの半導体・電子部品生産はプラス成長を堅持

事業機会

- 米国Fabless企業を中心に台湾への発注は活発化しつつある
- 新規成長市場としてLED切断用レーザーの引き合いが活発化
- 薄化は今後もさらに高い技術力や生産性向上を求められる

●当期の事業環境と経営方針について説明します。経済を取り巻く環境としては、米国のサブプライム問題に端を発した金融懸念や原油高、原材料高騰の要因など、実体経済への影響が分かりにくくなっており、半導体業界にとっては必ずしも好ましい状況ではありません。半導体業界全体では市場環境はやや低調と考えています。

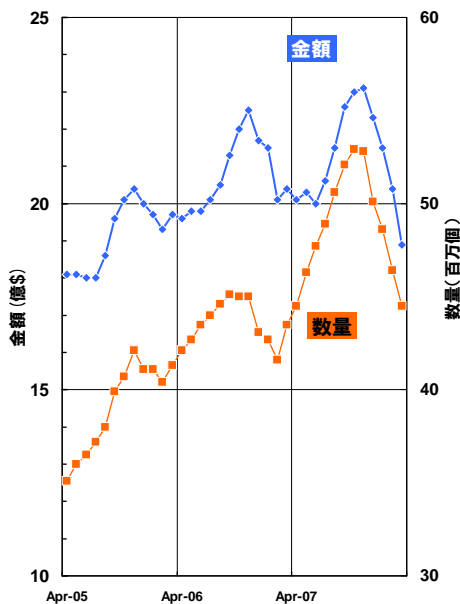
●そのような中で、半導体業界全体を見ると2つのカテゴリーに分かれると見ています。

●一つは市場の動きをうかがっている分野で、メモリ市場がその代表です。関連した地域として韓国が挙げられます。この市場では、まず製品の価格動向によって韓国メーカの設備投資が今後どのように回復するのかという点に注目しています。また日本メーカも積極的な投資に動いており、このような動きを受けて韓国メーカがさらにどのような対応をするか、という意味でも注目しています。暦年ベースの第1四半期では韓国メーカの投資は活発でなかったことから、第3四半期、第4四半期については楽観視していません。

●一方、積極的に投資する分野では、LEDに代表される市場があります。この市場では、現在台湾が積極的に動いています。LEDの用途は、PC、TV用のバックライト向け等で、急成長している市場です。

●2008年以降、このLED市場が更に大きく伸びると見込んでいます。台湾はLEDの生産拠点として投資が活発であり、一部中国への移管（ローエンド品）が進んでいます。

半導体出荷推移(WSTS)



市場環境

- 半導体業界全体は低調
 - 市場の動きを窺っている分野/メモリ
 - 積極的に投資する分野/LED
- 08年度半導体製造装置の投資動向
 - 調整期間は長期化しない
 - 組立装置の落ち込みは装置市場全体と比べると小さい
- 数量ベースでの半導体・電子部品生産はプラス成長を堅持

事業機会

- 米国Fabless企業を中心に台湾への発注は活発化しつつある
- 新規成長市場としてLED切断用レーザの引き合いが活発化
- 薄化は今後もさらに高い技術力や生産性向上を求められる

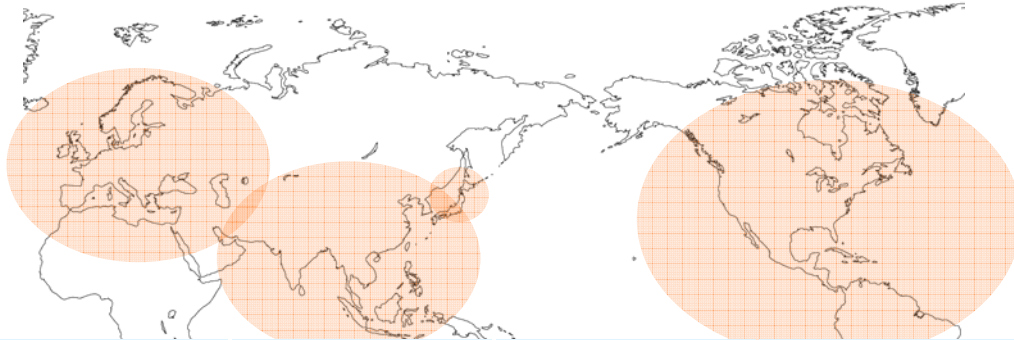
●当社の事業機会という観点から、サブコンを中心とした台湾の動向に期待以上の動きが出てきています。同地域は、前工程から最終製品市場の組み立てまでを行う完結した地域であり、現在、米国Fabless企業および日本企業から台湾への発注が活発化しています。LEDバックライト以外にも、グラフィックICやLCDドライバー等の生産拠点になっており、この引き合いも活発化してきています。

●LED切断用レーザについては、LEDの基板を直接切断する用途と樹脂成型されたチップを切断する用途があり、当社の切断装置にとって大きな事業機会と捉えています。

●米国Fabless企業の台湾への発注の動きとLED関連の需要拡大が、当社の事業機会においてプラス(+)の要因として働くと考えています。

地域別 事業の動向

各地域のニーズに柔軟に対応し、顧客価値の最大化を図る



欧州	アジア	日本	北米地域
<ul style="list-style-type: none">ディスコ独自の先端技術開発を先導TAIKO(車載半導体) DBGなどで実績あり	<ul style="list-style-type: none">アプリケーション対応の拠点を設置(台湾・中国)中国事業の伸びが高い	<ul style="list-style-type: none">戦略投資への対応力強化最先端の薄化技術レーザアプリケーションも多様化	<ul style="list-style-type: none">大手IDMの開発期間の短縮化量産への対応力の強化

●図は、地域別の当社事業の概況を整理したものです。

●欧州地域では、先端の技術ニーズを捉えようとしています。車載半導体の加工用途として当社が独自開発したTAIKOなどの導入も進んでいます。

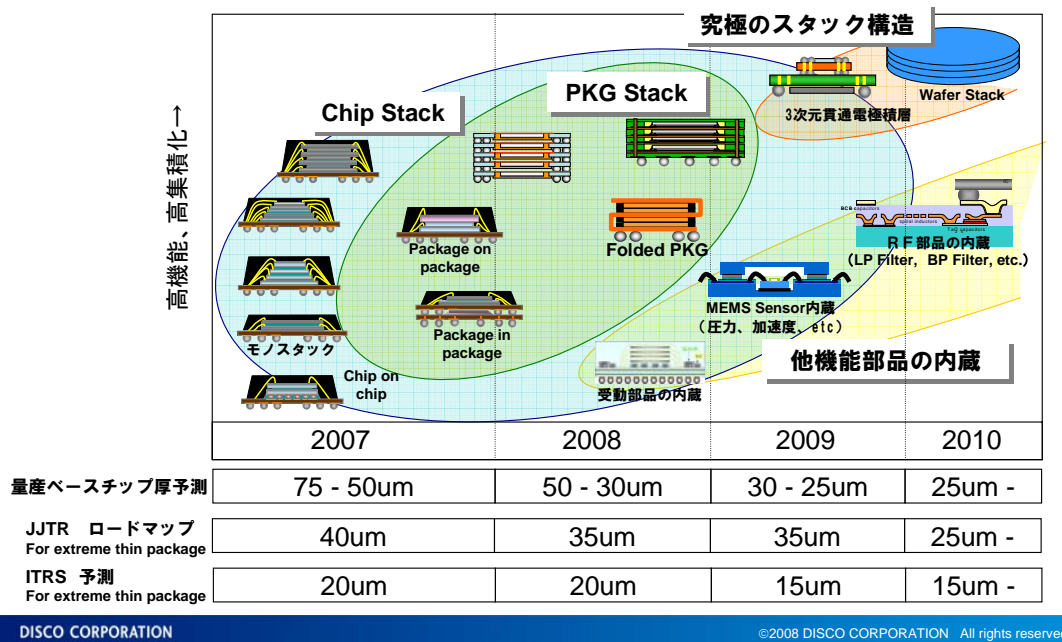
●アジア地域は、生産拠点としての重要性から当社がますます力を入れようとしている地域です。アプリケーションラボを活用してお客様への対応強化に努めていきます。

●日本では、戦略投資と多様化するレーザアプリケーションへの対応を進めていく考えです。

●北米地域は、アジアからの生産移管が行われていますが、幾つかの企業は大規模な量産を継続しており、対応力の強化に努めていきます。

最新技術動向

SiPから実装の更なる高密度化 積層化に向けたThrough Silicon Via (TSV)技術へ



●図は、薄化の技術的なトレンドを示したものです。最近ではNANDフラッシュメモリを中心に、スタック（積層化）する技術ニーズがますます強まっており、チップ厚を薄くする需要が拡大しています。

●2008年時点では、コスト面を考慮すると、ワイヤボンディングによるスタック（積層化）がまだ主流となっています。

●数年先には、上図にあるように3次元実装による形態が求められると予想しています。

●薄化市場では、薄くするほど技術的な問題も発生してくる（電気特性が不良化する等）ため、このような技術課題にきっちりと対応していくことが大事です。



最新 薄化インラインシステム DGP8761-DFM2800



DGP8761 加工点 (手前左側が3軸目【ストレスリリーフ】)

- メモリーメーカーの採算悪化により、07年末より投資を先送り
- 一方で第4四半期にロジック向けの出荷が堅調
- 08年度は、更なる高度な薄化技術開発案件に取り組む

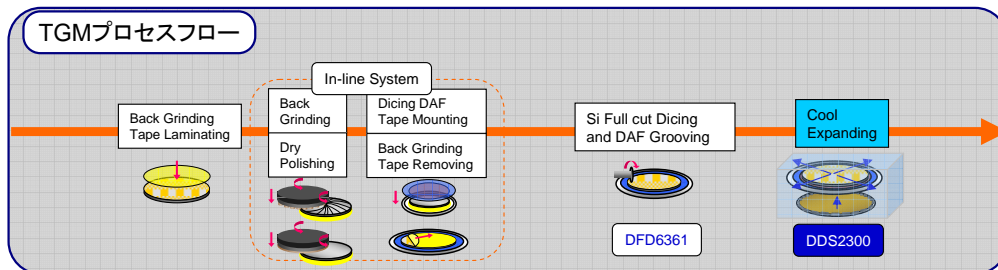
- スライドでは、当社の戦略分野である薄化市場の概況についてまとめています。

- アプリケーション開発を進化させ、高度化する技術ニーズへ対応

→08年度はDGP8761-DFM2800インラインシステムの評価・引き合いを継続して実施

→TGM (Thin Grinding Mounting)プロセスフローを確立

DDS2300を使用することで、DAF付きチップのピックアップ性が大幅に向上



- 薄化分野では、アプリケーション開発を進化させ、高度化する技術ニーズへの対応を進めていきます。

- 図中のTGMプロセスフローは大幅に伸びることを期待しています。



DFL7260

- Low-k用途のほか、LED向け
サファイアウェーハ用途も拡大中

→07年度よりLED向け装置の出荷が増大
(08年度も継続する見込み)

照明・車載・TV/PCバックライト等の需要増へ対応

→国内大手LEDメーカーのDFL導入により
他メーカーに波及する可能性あり

- 大手IDMだけでなく、サブコン向けの出荷も堅調

- レーザ分野では、Low-k用途、LED向け用途が拡大しています。

- セミコンジャパン2007にて発表したステルスダイシングを行うDFL7340・DFL7360の評価引き合いが多数

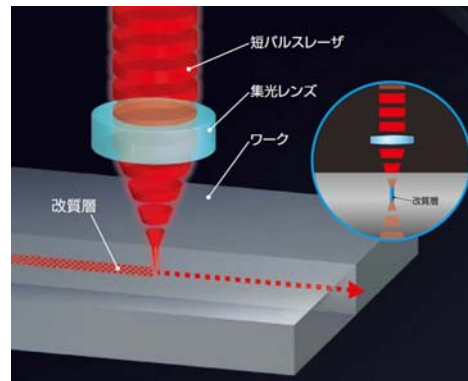
→特に、加工負荷・加工屑を嫌うMEMSデバイスメーカーなど



DFL7360(300mm)



DFL7340(8Inch)



ステルスダイシング技術

- 昨年のセミコンジャパン2007で発表したステルスダイシングの評価引き合いが活発化しています。

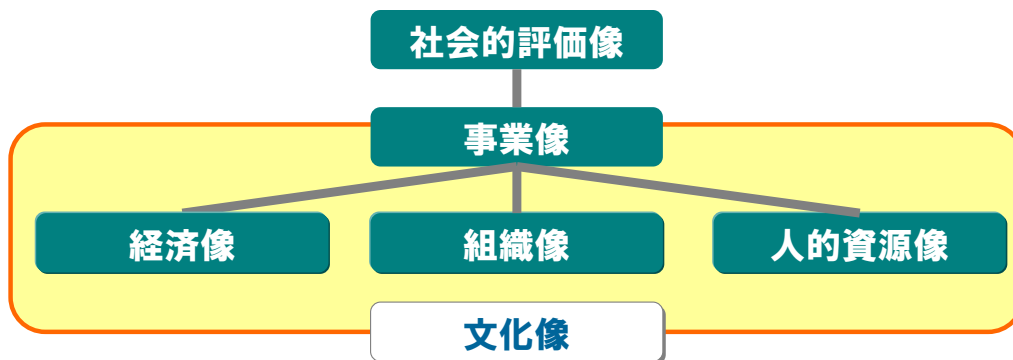
経営方針



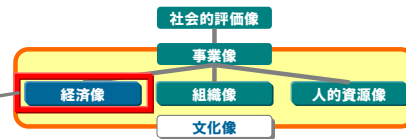
●当社はMission実現のため活動していますが、2010年のVISION実現を目指して絞った活動を行っています。

● DISCO VISION とは1995年から15年先の将来を見据えて、2010年のあるべき姿を策定したものです。

2010年における
ディスコのあるべき姿を6つの側面から定義



●図は、最終的に社会的評価像を得ることを目的として、ディスコのあるべき姿を6つの側面から定義していることを示しています。

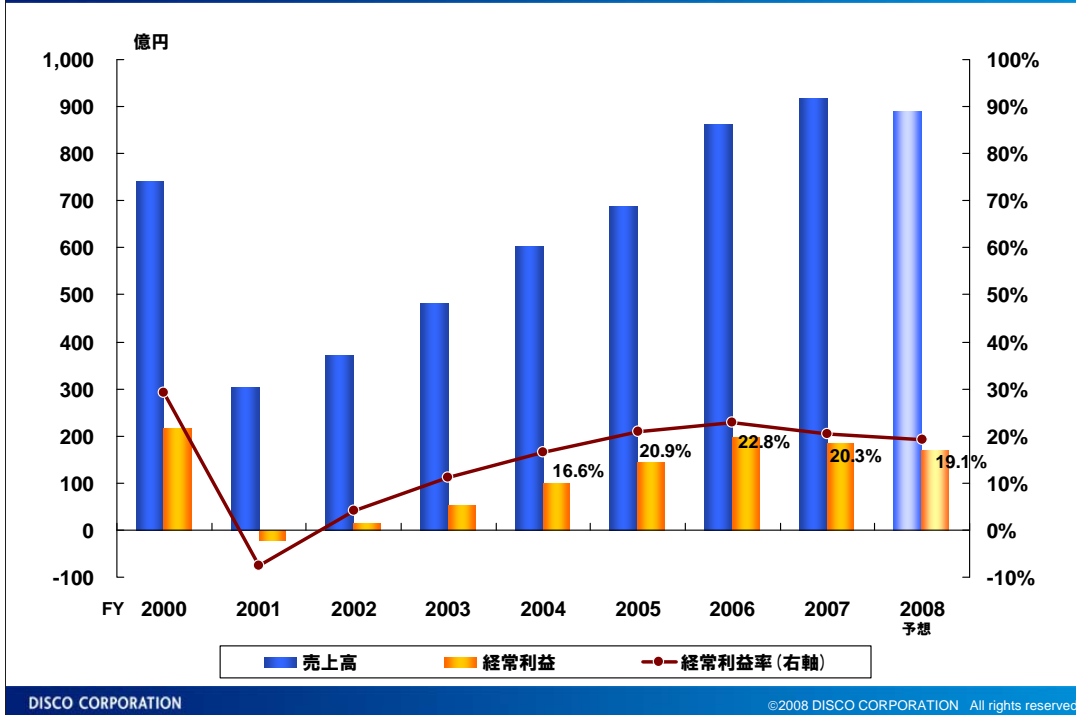


- 企業の成長を支える十分な経済的「**能力と構造**」を持っている

– 4年累計で、**20%以上の売上高経常利益率**を維持する態勢が出来ている

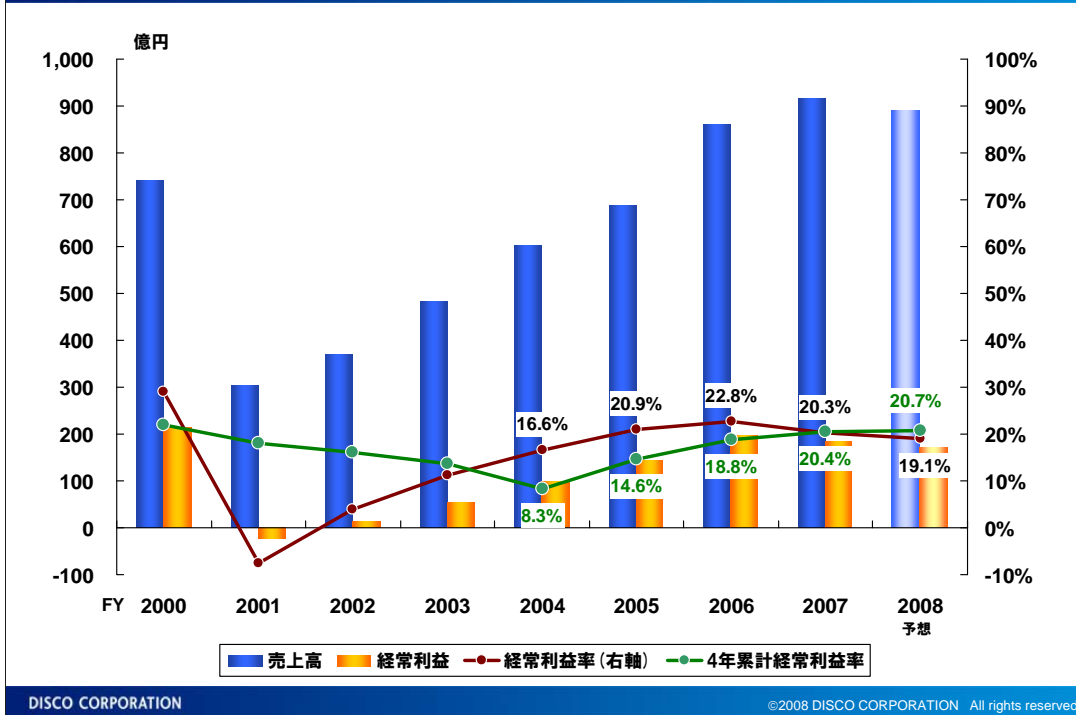
●6つの側面のひとつである経済像について、当社は市況の変動が激しい中にあって、4年累計で20%以上の売上高経常利益率を維持したいと考えています。

連結業績推移



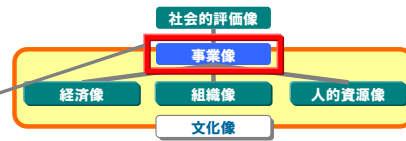
●当社業績は2001年度の赤字の状態から、以降6年間順調に回復してきました。

連結業績推移



●2007年度は、4年累計の経常利益率20.4%を達成しました。

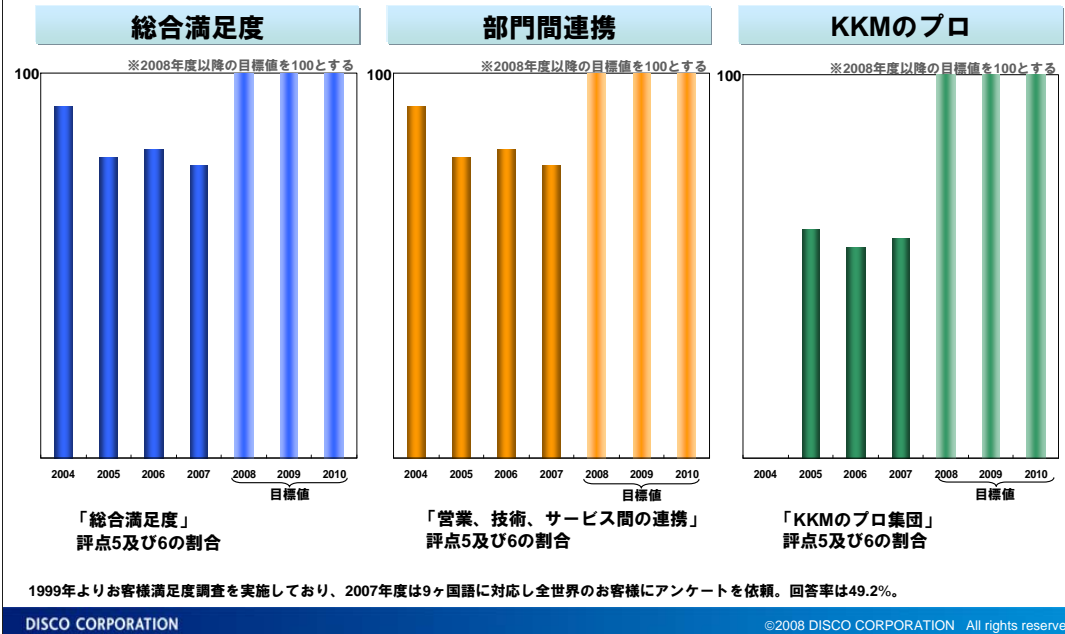
●2008年度も4年累計で20%以上(20.7%)を維持できる見通しです。



ハイテク業界において、
「Kiru・Kezuru・Migakuならディスコ」として
最も頼られる存在となっている

- 6つの側面のもう一つである事業像において、ディスコのあるべき姿を定義しています。

CS調査結果より、選ばれるディスコに進化



●スライドのグラフは、CS調査（お客様満足度調査）結果における3つの指標を選択して、その達成度を現しています。

●2008年以降の目標達成にむけて取り組んでいます。



●MISSION実現に一步でも近づくための取り組みとして、2つのアプローチで実践を行っています。

●1つはDISCO VALUESの浸透を図ることによって、企業文化の良質化を図ることです。VALUESは質の向上を醸成していくものです。

●それをドライブ（エンジンによって駆動）していくことに相当するものがPIM活動という位置づけです。

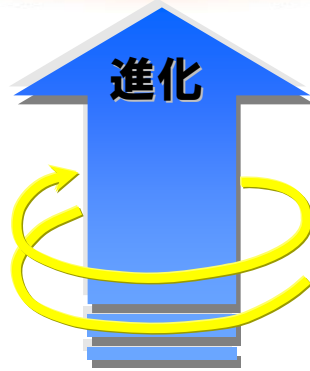
PIM活動

Performance Innovation Management

進化のためのツール

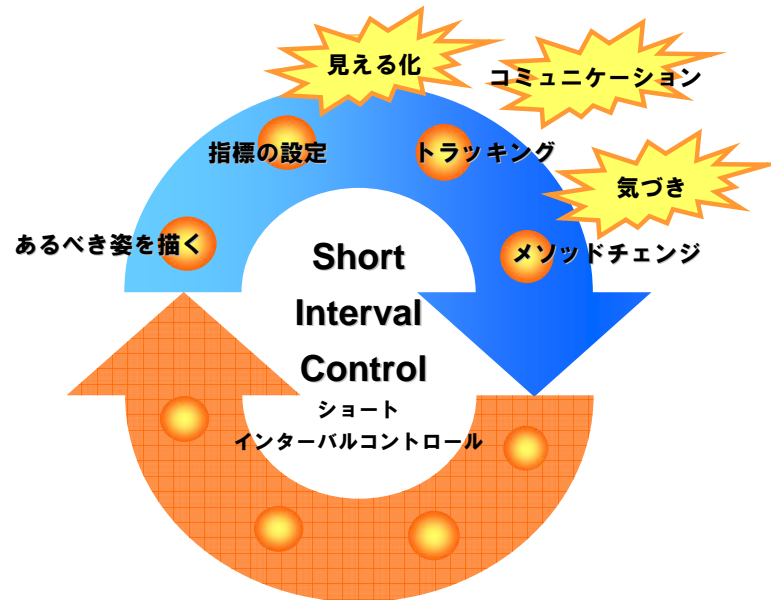
あるべき姿

進化



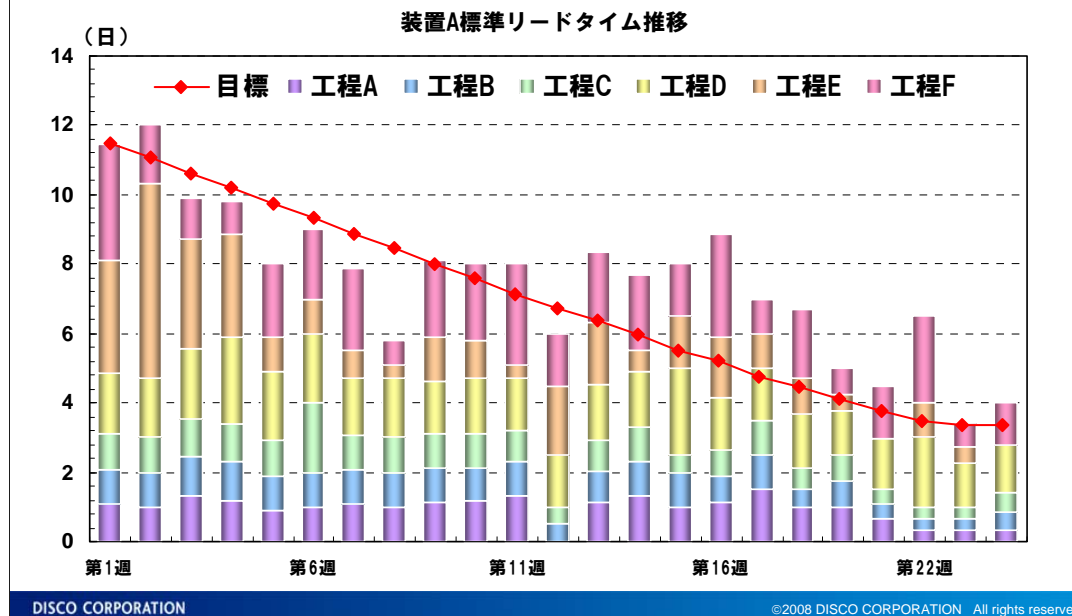
- PIM活動は、あるべき姿に向かって進化を促すためのツールとして捉えています。

短いサイクルで、気づきを得て、進化を促進



●PIM活動は、図のように短いサイクルで気づきを得て、あるべき姿に向けて進化を促進していくものです。

生産効率の改善



●グラフは、PIM活動によって生産効率改善に生かされた事例です。

●1週から22週目までの取り組みによって、ある製品の生産リードタイムを12日から4日へ、3分の1まで短縮化することができました。



本社・R&Dセンター II期工事

投資総額	80億円
完成予定	2008年11月
目的	<ul style="list-style-type: none"> • 研究開発から試作までの効率化 • アプリケーション開発スペース拡張 • ウェーハの大口径化対応 • BCM対応力の向上
建屋構造	免震構造 地下1階 地上14階

●当期の設備投資では、本社・R&Dセンター第2期工事が完成する予定です。

●設備投資の目的は、研究開発から試作までの効率化、アプリケーション開発スペースの拡張、ウェーハの大口径化対応、BCM対応力の向上です。



桑畑工場 新A棟工事
精密加工装置および精密加工ツール生産工場

投資総額	100億円
着工予定	2008年9月
完成予定	2009年12月
目的	<ul style="list-style-type: none"> ・製造現場の集約による効率向上 ・魅力ある労働環境の提供 ・需要拡大への対応 ・BCM対応力の向上
建屋構造	免震構造 地上8階



DISCO 茅野工場 I期工事
ダイイチコンポーネンツ 茅野工場

投資総額	25億円
着工予定	2008年8月
完成予定	2009年6月
目的	<ul style="list-style-type: none"> ・製造現場の集約による効率向上 ・魅力ある労働環境の提供 ・需要拡大への対応 ・BCM対応力の向上
建屋構造	免震構造 地上6階

●当期でのその他設備投資では、ダイイチコンポーネンツ茅野工場の新棟工事と桑畑工場新棟工事が、それぞれ今年の8月、9月から着工される予定となっています。

●製造現場の集約による効率向上、BCM対応力の向上などが目的となっています。

	中間期	期末	記念配当	年間
2008年3月期(案)	35円	44円	—	79円
2009年3月期(予想)	25円	46円	—	71円
(ご参考) 2007年3月期(実績)	30円	35円	10円	75円

【配当方針】

1. 連結業績に連動した配当（配当性向20%）
2. 安定配当として最低20円の配当金を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く。
3. 4年累計連結売上高経常利益率が20%を達成した場合、通常20%である配当性向を24%とする
4. 赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*2)を超過した場合は、上記①に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乘せする

【注】2008年3月期末時点予定必要資金額 300億円
現預金残高が予定必要資金額を超過しないため配当金の上乗せはなし

●最後に配当について、

2006年度は年間75円の実績。

2007年度は年間79円を予定しています。

●従来から連結業績に連動して20%の配当性向を指針としていましたが、今回配当施策の変更として、4年累計の連結売上高経常利益率が20%を達成した場合、20%の配当性向を24%とすることを追加しました。

●2007年度はこの規定により24%の配当性向が適用され、2008年度も24%が適用される見通しです。

1. 2008年3月期決算概要

常務取締役 I R 担当

関家圭三

2. 今期の事業環境と経営方針

代表取締役社長

溝呂木 斉

3. 質疑応答

ご清聴ありがとうございました。

DISCO
Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



DISCO CORPORATION